

# Stockage Flash : Toshiba et Western Digital visent les 64 Go par composant

**Western Digital et Toshiba** se sont associés pour mettre au point des composants Flash NAND BiCS3 d'une capacité inédite de 256 gigabits (32 Go). À cet effet, une nouvelle technique de fabrication 3D à **64 couches** est utilisée, contre 48 couches précédemment.

Cette montée en gamme permet d'offrir des composants d'une capacité **40 % supérieure**, assure Toshiba, avec en ligne de mire des puces de **512 gigabits** (64 Go).

Des échantillons de composants BiCS3 seront livrés aux constructeurs dès ce trimestre. Pour la production de masse il faudra toutefois attendre le quatrième trimestre 2016. Les livraisons « dans des quantités significatives » sont programmées pour **le premier semestre 2017**.

## Des composants TLC

Ces composants plus denses permettront d'améliorer la capacité des modules **eMMC** des smartphones et tablettes, et des cartes mémoire. Voire des unités de stockage Flash compactes, comme les **SSD M.2**. Leur impact sur le marché devrait être moins marqué dans le secteur des SSD 2,5 pouces, présentant un volume plus important.

Pensés pour être avant tout économiques, ces composants utilisent le mode **TLC**, soit 3 bits par cellule. Contre 2 bits par cellule pour les offres MLC, plus endurantes. Ceci les disqualifie en partie dans les datacenters, où il faudra éviter de les utiliser dans des scénarios d'écritures intensives, pour les réserver au stockage de données tièdes.

### À lire aussi :

[Toshiba booste la vitesse et réduit la consommation des puces flash Nand](#)

[Raspberry Pi : le PiDrive de Western Digital accessible en France](#)

[Avec la mémoire PCM, IBM veut révolutionner le stockage](#)

**Crédit photo :** ©